



连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：插座，CuSn4，方柱，信号，20 号



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

壳体内部的端子定位器类型: 卡口

端子大小: 尺寸 20

线缆端接方法: 焊接

[所有 D-Sub 连接器端子：插座，CuSn4，方柱，信号，20 号 \(4\)](#)

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子大小	尺寸 20
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3.1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
线缆端接方法	焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件



带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	卡口

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE HDP](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

[20 DF SKT CONTACT DUPLEX/LP](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-745288-5_AP.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-745288-5_AP.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-745288-5_AP.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors](#)

英文版本

[AMPLIMITE Cable Connectors and Shielding Hardware Kits QRG](#)

英文版本